DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03367023

\*\*Image available\*\*

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

**03-029923** [JP 3029923 A]

PUBLISHED:

February 07, 1991 (19910207)

INVENTOR(s): MATSUMOTO SHINZO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

01-163935 [JP 89163935]

APPL. NO.: FILED:

June 28, 1989 (19890628)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/1333; G02F-001/136

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R011 (LIQUID CRYSTALS); R124 (CHEMISTRY -- Epoxy Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1194, Vol. 15, No. 162, Pg. 87, April

23, 1991 (19910423)

# **ABSTRACT**

PURPOSE: To prevent a fear of lead disconnection of TAB (tape automated bonding) and to improve the reliability by providing a driving IC, which drives a liquid crystal display panel mounted on a glass substrate, and an EPC electrically connected to the input wiring of the driving IC with an isotropic conductive film between them.

CONSTITUTION: A driving IC 7 is positioned and adhered on transparent glass substrate 6 with an adhesive for IC and is bonded to wiring patterns 8 and 9 by bonding wires. The driving IC 7, bonding wires, and the bonding part are coated with a resin, and FPCs 10a to 10d on which a controller 11 and chip parts 12 are preliminarily mounted are positioned on a wiring pattern 9 and are connected with the anisotropic conductive film. Inter-EPC connection wiring patterns 20 to connect FPCs 10a to 10d to one another are connected by the anisotropic conductive film also. Thus, this device is free from lead disconnection of TAB to improve the reliability because TAB is not used.

DLALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

9696006

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 3029923 A2 910207 <No. of Patents: 002>

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): MATSUMOTO SHINZO

IPC: \*G02F-001/1333; G02F-001/136 JAPIO Reference No: 150162P000087

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 3029923 A2 910207 JP 89163935 A 890628 (BASIC)

JP 2880186 B2 990405 JP 89163935 A 890628

Priority Data (No,Kind,Date): JP 89163935 A 890628

# 町正有り

# ⑩日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

# 母公開特許公報(A) 平3-29923

Dint.Cl.

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)2月7日

G 02 F

1/1333 1/136

500

8806-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

50発明の名称

液晶表示装置

本

②特 願 平1-163935

❷出 願 平1(1989)6月28日

@ 希明者 松

信 三

勝男

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

⑦出 顧 人 株式会社

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川

外1名

## 明 細 吾

- 1. 発明の名称 被晶表示装置
- 2. 特許請求の範囲

  - 2. 上部ガラス基板とそれより寸法の大きい下部 ガラス基板と上記両基板間に封入・対止され た液晶とを具備して成る液晶表示パネルと、 上記上部ガラス基板の外側の上記下部ガラス 基板上に設けられた上記板晶表示パネルの配 動配線と、上記下部ガラス基板上に実装され、

上記被品表示パネルを駆動するための駆動 I C と、上記聚動 I C の入力配線と異方性滞電 腰を介して電気的に接続され、上記下部ガラス基板の複数辺の開囲に配置された複数の下 P C とを具備し、上記下 P C 同志が上記で部 ガラス基板上に設けられた接続用配線によって接続され、かつ上記各 F P C と上記接続用 配線とは異方性導電機を介して接続されていることを特徴とする被品表示装置。

3. 発明の詳細な説明 (表質エの利用分野) <del>「表明の日本る技術分野)</del>

本発明は、被品表示装置、特に、球膜トランジスタ等を使用したアクティブ・マトリクス方式で、 かつシールドケースがフラットタイプの被晶表示 装置に関する。

# 〔従来の技術〕

アクティブ・マトリックス方式の被品表示装置 は、マトリクス状に配列された複数の関素電腦の 各々に対応して非線形素子 (スイッチング素子) を設けたものである。各両素における被品は懸針 的には常時限的(デューティ比1.0)されているので、時分割駆動方式を採用している。いわゆる単位マトリクス方式と比べてアクティブ方式はコントラストが良く、特にカラーでは欠かせない技術となりつつある。スイッチングボチとして代表的なものとしては溶取トランジスタ(TFT)がある。

例えば、森原トランジジスタと西妻電話とを方式式の一口ので変異とするアクティブ・マトリクスス度ののカラー被監査を設置は、マトリクスは、では、変異が配置された被晶表示パネル(LCD配線をする、被晶表示パネルのを直接をは、には、なのをでは、なのをでは、なのででは、ないのでは、ないいのでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないではないではないでは、ないのでは、ないではないでは、ないではないではないでは、ないではないではないではないではないではないではないでは

故呂表示パネルは、下部(被品を基準とする) 適明ガラス基板上に薄膜トランジスタおよび透明 世来のフラットタイプの液晶表示装置は、主として上下 2 枚の 薄いシールドケースと、溶成トラングスタアレイを有し、シールドケースにあけられた窓に取り付けられる液晶表示パネルと、 故品表示パネルを理動させる半導体集積回路チップ (以下医励ICという)を実装したTAB(テイド ボンディング)と、 TABを搭載したプリント配線基板(PCB)とから視底される、波品表示パネルの周辺部(上部ガラス

- 3 -

- -

基板より寸法の大きい下部ガラス基板上)に双けられた驅動配線の入力電子と、TABの出力母アウタリードとが異方性感覚膜(面に対しれる方向には透が流れるが、水平方向には近れれないとなっているの入力母に対している。を持った場の人力母に接続である。を登りたいるのはは、なりにはないの外部の信号とが出手段に対射を観視されるに、変している。をいる。をいる。といるのインナリードとがボンディングされている。

液晶表示パネル、躍動ICを実装したTAB、PCB等の各部品は、シールドケース内に内蔵され、2枚のシールドケースは組み合わされて固定されている。また、各シールドケースには液晶投示パネル用の窓が設けられ、この窓に被晶表示パネルがはめ込まれ、放晶投示両面が築窓から見えるようになっている。

なお、TFTを使用したアクティブ・マトリクス 液晶 表示装置は、 例えば「冗長構成を採用した

- 4 -

12.5型アクティブ・マトリクス方式カラー被晶ディスプレイ』、日経エレクトロニクス、 193~210頁、1986年12月15日、日経マグロウヒル社発行、で知られている。

# (発明が解決しようとする課題)

世来の液品表示装置では、路に対する信頼性が充分でないTABを使用するので、ヒートサイクルは頭時や使用時にTABのリードが切れることが多く、また工役が多い等の点で製造コストが高くなる問題がある。

また、TABを用いず、座路ICをガラス基板上に直接実装するいわゆるCOG(チップ オングラス)実装も提案されている。しかし、従来は、半田付けにより座型IC、PCB、FPCを接続するため、ガラス基板上に形成した配線パターンにAuめっき等を施したりするので工数が多く、かつ半田付け工程は200℃以上に温度を上げるので、配線パターンが刺殺しるい等の問題がある。

本発明の目的は、TABを使用しないで、信貸 性を向上でき、製造コストを低減でき、かつ工数 が少なく設造工程が簡略である被品表示装置を提供することにある。

# . [課題を解決するための手段]

また、本発明の被品表示装置は、上記PPCが上記下部ガラス基版の複数辺の周囲に配置され、上記FPC同志が上記下部ガラス基版上に設けられた接続用配線によって接続され、かつ上記FPCと上記接號用配線とは異方性符電膜を介して接続されていることを特徴とする。

〔作用〕

- 7 -

ス基板SUB2上にブラックマトリクスBM、カラーフィルタドIL、カラーフィルタドILの保護膜PSV2、共通透明両素電極ITO2、上部配向膜ORI2が順次設けられた第2の基板と、両基板SUB1、SUB2の各配向膜ORJ1、OR12の間に対入された被品LCを対入するためのシール材(封止部村)SLとによって解放されている。下部通明ガラス基板SUB1の厚さは、例えば1.1m程度である。

第3回の中央部は一個素部分の断面を示しているが、左側は透明ガラス基板SUB1 およびSUB2の左側線部分で外部引出配線の存在する部分の断面を示している。右側は、透明ガラス基板SUB1 およびSUB2 の右側線部分で外部引出配線の存在しない部分の断面を示している。

被品表示パネルの銀速方法では、上記第1の基板と、上記第2の基板とを別々に形成し、両基板の互いの配向膜ORII、ORI2が向き合うように、両基板間にスペーサ材(図示されていない)

本発明の被品表示较度では、腹筋ICを直接ガラス基板上に実装し、TABを使用しないので、TABのリードの切断のおそれがなく個額性を向上できる。また、TABおよび半田付けを使用しないで異方性容を厚を使用するので、配線パターンの利難が生じず、工数を減少でき、製造工程を同略化できる。

本 発明の 他の 目的 および 特敵 は 図 面 を 参 塚 し た 以下の 数 明 から 明 ら かと なるで あろう。

#### (宝海州)

第2図は本発明の一実施例のアクティブ・マトリクス方式のカラー液晶製示装置の液晶製示部の 所面図、第3図は液晶製示部の等価回路図である。 《パネル斯面全体器度》

第2回に示すように、液晶表示パネルは、液晶 居LCを基準に下部透明ガラス基板SUB1上に 程度トランジスタTFT1および強明画素電極I TO1、薄度トランジスタTFTの保政膜PSV 1、液晶分子の向きを設定する下部配向膜ORI 1が頑次設けられた第1の基版と、上部透明ガラ

-8-

を介在させることにより所定の間隔を置いて選ね合わせ、可基板間に被品LCを封入し、両基板の周囲に設けられるシール材SLによって封止することによって組み立てられる。下部透明ガラス版板SUB1 側には、パックライトBLが配置されている。

第2回の左回、右側のそれぞれに示すシール材 SLは、液晶LCを対止するように構成されてむ り、液晶対入口(図示していない)を除く透明ガ ラス基板SUB1ちよびSUB2の熱周四全体に 沿って設けられ、例えば、エポキシ樹脂で構成さ れる。

上部透明ガラス基板SUB2個の共通透明電板ITO2は、少なくとも一個所において、銀ペースト材SILによって、下部透明ガラス基板SUB1個に設けられた外部引出配線に接続されている。この外部引出配線は、登明面柔電極層ITO1で形成される。

起向膜ORI1およびORI2、透明商素電話 ITO1、共通透明信毎ITO2は、シール材S Lの内側に致けられる。 無光板 P O L は、下名遺 明ガラス基板 S U B 1 、 上部透明ガラス基板 S U B 2 のそれぞれの外側の表面に設けられている。

透明面素電極ITO1と稼襲トランジスタTF Tとは、函素ごとに設けられている。

#### 〈寐腹トラングスタTFT♪

- 11 -

S U B 1 を収換側(外部露出側)とすることもできる

# 《共通電板ITO2》

共通透明電板ITO2は、下部透明ガラス基板 SUB1 側に西帯ごとに設けられた透明西港電板 ITO1に対向して配置され、複数の両帯電板ITOに対して共通となるように構成されている。 この共通透明電板ITO2には、共通電圧が印加されるようになっている。

# 《表示パネル全体等価目路》

この数晶表示数質の等価回路を類3回に示す。 前記被晶表示部の各面表は、 走査信号線で1、 で 2、 … が延在する方向と同一列方向に複数配配され、 画素列X i G . X i B . X i + 1 R . … のそれ、 を構成している。 カラーフィルタFILは、 面素に対向する位置に 各面素 毎に ドット状に 形成され、 集色フィルタ G が形成される B . X i + 1 B . … は、 操色フィルタ B が形成される 調素に 姿貌される 国素に 姿貌さ 表示装置の回路ではその概性は動作中反転するので、ソース・ドレインは動作中入れ替わると理解されたい。 しかし、以下の説明でも、便宜上一方をソース、他方をドレインと固定して表現する。 酵膜トランジスタTFTのソース電便SDIは、 透明画素電優ITO1に接続され、ドレイン電係 SD2は、映像信号級DLに接続され、かつ、ゲート電低GTは、走査信号級GLに接続されてい

#### < 選出題 B M →

なお、パックライトをSUB2餌に取り付け、

- 12 -

第1図(A)は本発明の一実施例の被品表示数型の分解斜視図、第1図(B)は被品表示パネル、配線パターン、FPC、報動IC等を示す第1図 (A)の部分拡大斜視図、第1図(C)は被品及示パネル、FPC等の部分断面図である。

1は上シールドケース、2はゴム等から成る押

5

え用スペーサ、3は上シールドケース1に一体に 形成されたかしめ用凸部、4は被品表示パネル、 5 は上部選明ガラス基板、 6 は下部透明ガラス基 板である。下部避明ガラス基板6上には上部透明 ガラス基板5が重ねられ、両基板間にはここでは 國示しない被晶が封入、封止されている。下部渡 明ガラス基板6は上部避明ガラス基板5より寸法 が大きく、上部波明ガラス基板5の4辺の外耳部 が被晶表示パネル4の座勁配換用領域となる。7 は壓頂IC、8は下部透明ガラス基板6上に形成 された区功配線パターン、9は原助IC7の入力 配縁パターン。10a、10b、10c、10d は下部諸明ガラス基板6の4辺の周囲に致けられ たFPC、11はビデオ信号をTFT鹿助用信号 に変換するためのコントローラ、12はコンデン サー、抵抗素子、受助素子等のチップ部品、13 はパソコン等からのデータを送り込んでくるコネ クタが挿入されるコネクタ部、14はFPC10 a~10dを下部避明ガラス基板6に取り付ける ための粘着テープ、15は下シールドケース、

ルドケース15にあけられたかしめ穴、17はシ ールドケースのアース、18は絶縁阻ビニルシー ト、19はFPCのアースである。 第1回 (B) において、20はFPClOa~10d両志を接 様するための配線パターン、第1回(C)におい て、21はFPC10a~10dと下部進明ガラ ス基板6の配線パターン9、20との間に設けら れた異方性収量膜、22は距動IC7と配線パタ ーン8、9とを接続するためのポンディングワイ ヤ、23は壓勁IC7と接続されたポンディング ワイヤ22を保設、固定するためのモールドレジ ン、24は座助1C7を下部産明ガラス基板6に 接着するためのIC用接着剤、25はかしめ用凸 部3のかしめ部分、26は上部透明ガラス基板5 と下部透明ガラス芸板6の外側の表面に設けられ た日光板である。なお、図示はしてないが、バッ クライト光を拡散する拡散板も下シールドケース 15に接着剤等で付けることも可能である。 次に、被島表示装置の実装方法について説明す

16はかしめ用凸部3が挿入されるための下シー

- 15 -

る。第1 図(A)、(B)に示すように、まず、 駆動IC7をIC用接着和24を用いて下部透明 ガラス基板6上に位置決めして接着し、ポンディン グワイヤ22により配線パターン8、9のポンン ディングする。配数パターン8、9のポンス・イン グのイヤ22により配線パターン8、9のポンポン グのイヤ22により配数パターン8、9のポンポン グのはは数なA2/CrあるいはA2と した。次に、信観性を確くするため、第1 図イヤ した。すように、呪動IC7をめ、第1 図イヤ 22とポンディング部を樹足のこうにでいるといる。なお、ワイヤチブン23)、イヤガンディング時には、 を完成が10 V D T(10 インチ ヴィジュアル ディ を記数が10 V D T(10 インチ ヴィジュアル ディングを に スプレイ ターミナル)では的2000本となるため、 パラレルポンディングを採用し、工程短頭を行っ た・

次に、コントローラ11およびチップ部品12が予め実装されたFPC10a~10dを配線パターン9へ位置決めし、異方性事電膜21を用いて接続する。このとき、FPC10a~10dとFPC同志を接続するFPC間接破用配はパター

- 16 -

20も同時に具方性容は度21により接続する。 配理パターン9、20は異方性導電膜の電波浴度 を考慮し、できるだけ接対面を大きく数があるだけ接近を大きくができるだけ接近を大きる数パタターした。 す、20の材質はITO(ネナように、解析とした。 本で10dを下PC10 本で10dを下PC10 本で10dを下PC10 本で10dを下PC10 本で10dを下PC10 本で10dを下PC10 本で10dを用いて接近のの(B)に、解析を10dのではあるでは、通過では、通過では、通過では、通過では、が、 被量表示パネル自体の超級にはありには、が、 を受けるが損傷を受けるのにより 切りに示す。 を受けるではないたしたした。 第1回(B)に示す。 第1回(B)に示す。 第1回(B)に示す。 第1回(B)に示す。 第1回(C)に示す。 第1回(C)に示言。 第1回(C)に示言。 第1回(C)に言言。 第1回(C)に言言。 第1回(C)に言言。 第1回(C)に言言。 

次に、第1回(B)に示す組立体をシールドケース1、15内に収納し、シールドケース1、15の組み立てを行う。シールドケース1、15はかしめ用凸部3とかしめ穴16により第1回(C)のかしめ部分25に示すようにかしめられて規定される。このとき、上シールドケース1と

5

第1回(B)の組立体との間にゴム等から及るスペーサ 2 を介在ではり、FPC10 a~10 dと下部間に対しての配数は21のの配数は21のの配数は対したないでは、ないのではないで、数回(A)ので接続のに、第1回ではないのででは、では、ないのでではない。第1回ではないのででは、ないのでは、ないのででは、ないのででは、ないのででは、ないのでは、ないのではないのででは、ないのででは、ないのでは、

第4図は、被晶炎示パネルの下部透明ガラス基 仮の部分平面図である。本実施例では、軽動IC 7への入力配線パターン9とドPC10a~10 d間接続用配級パターン20の片側(あるいは両側)にFPC10a~10dの下部透明ガラス基 板 5への接着力を増すためにダミー端子27が複 数 数 けられている。 ダミー端子27が複 しない。つまり、表示回路が世気的に切り離され

- 19 **-**

き、電流客量の点でも充分に満足できる。従って 本実施例では、軽低、小型で安価な液晶表示装置 を提供できる。

以上本発明の実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなり、これを選挙を選択しない範囲において、他であることは知識である。例えば、自記を強減するのは、「中で10a~10d回志を投稿するのとは、「中で10a~10d回志を明ガラスが、「中で10a~10d回志を一部監督に、「中で10a~10d回志を一部監督に、「中で10a~10d回志を一部監督に接続用選子をそれぞれ設けて接続してもよい。

## 〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の被品表示妄葉に よれば、駆動ICを直接ガラス提板上に実装し、 TABを使用しないので、TABのリードの切断 のおそれがなく信頼性を向上できる。また、TA Bおよび半田付けを使用しないで異方性調金額を た端子であり、電気的には浮いた(フローティン グの)端子とされる。

本実施例の被晶表示装置では、距頭IC7をド 部選明ガラス基板6上に実装し、TABを使用し ないので、TABのリードの切断のおそれがなく 肩頼住を向上できる。また、TABを使用しない ので、工数を減少でき、製造コストを低減できる。 また、TABを使用せず、接続時の温度が低く加 競時間が少ない異方性導電膜21を使用して配線 パターン9、20とFPC10a~10dを接続 するので、配線パターンの到離が生じず、工数を 減少でき、製造工器を簡略化でき、製造コストを 低減できる。また、ドPCIOa~10d肩近の 接続は、下部透明ガラス基板6上に形成した接続 用配線パターン20にFPCを異方性基ជ膜21 を介して接続するため、FPC間接続用のFPC 等の接続部品が不要なので、工数、製造コストを 低減できる。さらに、異方性導電膜21により接 続される箇所の配線パターンの大きさは、配線形 波領域のスペースは広いので大きくすることがで

- 20 -

使用するので、配舗パターンの剥離が生じず、工 数を減少でき、製造工程を簡略化できるため、製 造コストを低減できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図(A)は本発明の一実施例の被品表示装置の分解斜視回、第1図(B)は被品表示パネル、配線パターン。FPC、駆動IC等を示す第1回(A)の部分拡大図、第1図(C)はある示パネル、FPC等の部分を同回、第2回は本発明の一変最表示投資のである。第3図は被品表示形の下部透明ガラス基板の部分である。

1…上シールドケース

2…押え旧スペーサ

3…かしめ用凸部

4…蔵品表示パネル

5 …上部透明ガラス基板

である。一下部諸明ガラス基板

7 … 軽動 1 C

8 …蘇勁配線パターン

3一駆動ICの入力配線パターン

10 a. 10 b. 10 c. 10 d ... FPC

11…コントローラ

12ーチップ部品

13-コネクタ部

14… 粘着テープ

しら…下シールドケース

16一かしめ穴

17…シールドケースのアース

18…純蘇用ビニルシート

19 -- FPCのアース

20…FPC間接続用配線パターシ

21 -- 異方性薄電膜

22…ポンディングワイヤ

23ーモールドレジン

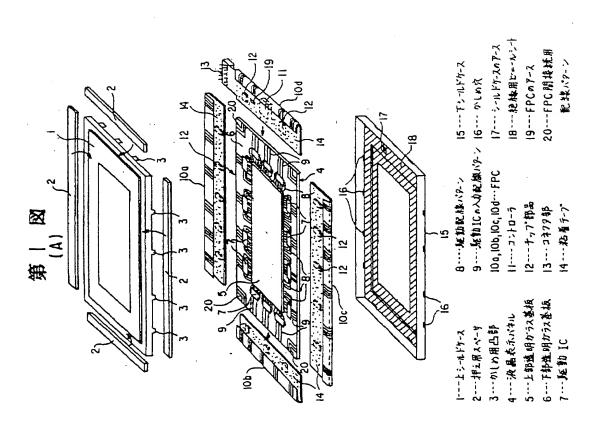
24… IC用接着剂

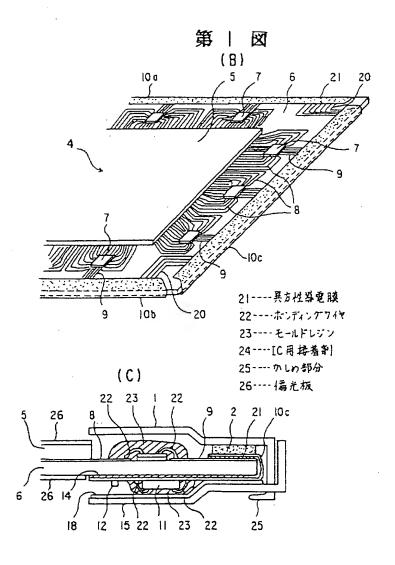
25…かしめ部分

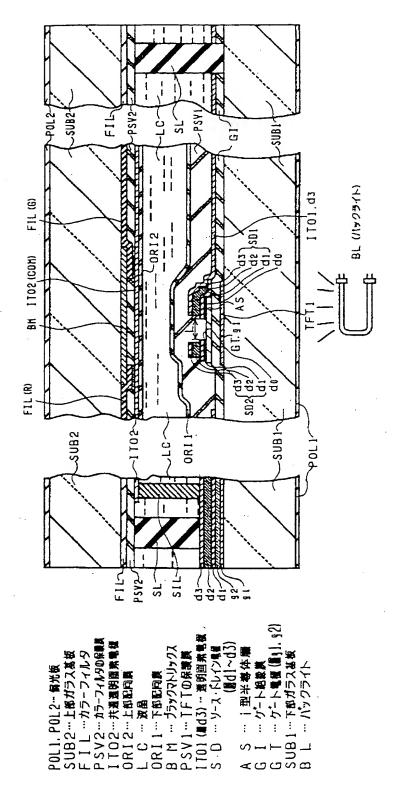
2.6 -- 偏光板

代理人弁理士 小川 **B** 贝尔斯

- 21 -



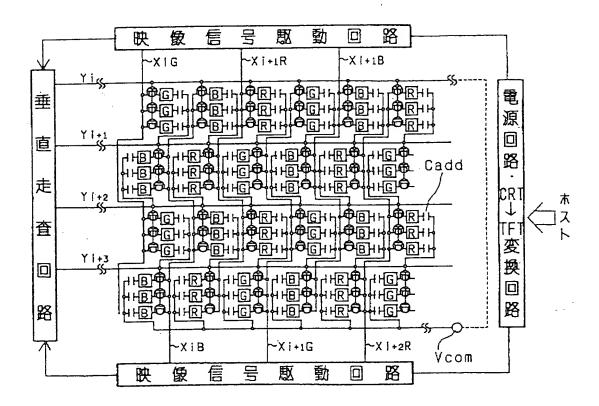




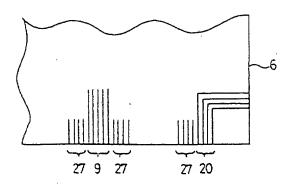
第2図

NO E TETECOL

第3図



第 4 國



6----下部透明ガラス基板

9----駆動IC n 入力配線パターン

20----FPC間接続用配線パタ-ン

27----ダ:- 端子